

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026年3月18日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	麦格理资本、国投证券、华创证券、孝庸私募、众安财保、兴银理财、安信基金、中海基金、太平养老、长盛基金
活动时间	3月10日、3月11日、3月13日
活动地点	策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、砺算科技的产品在3.12日发售，能否做一下介绍？</p> <p>答：3月12日，砺算科技携其自研GPU产品亮相AWE2026展会。在本次展会上，砺算科技展示了其自研TrueGPU天图架构GPU产品系列，并就产品市场推广计划进行了介绍。具体产品信息及业务进展请以砺算科技官方信息为准。敬请注意投资风险。</p> <p>2、SLC NAND价格上涨主要受到哪些影响？</p> <p>答：从供给端来看，海外大厂的产能结构向高密度3DNAND倾斜，SLC NAND等成熟工艺供给收缩，对于国内存储厂商而言，这一调整带来了结构性机遇。从需求端来看，市场增长主要来自两方面：一方面，网通设备迭代升级、安防监控智能化及物联网生态加速扩张，持续带动存储容量需求提升；另一方面，在智能穿戴设备等细分领域，SLC NAND</p>

	<p>Flash 凭借更快的擦写速度与更高的存储密度，已对 NOR Flash 在代码存储应用领域形成替代。</p> <p>3、在新产品的研发方面公司有哪些方向？</p> <p>答：公司围绕“存储”核心业务，在“存、算、联”一体化领域持续进行技术布局，并维持了高水平的研发投入。在存储板块，公司继续巩固 SLCNANDFlash 行业的技术领先优势，推动产品迭代升级，2025 年度报告期内 1xnm 闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售；公司进一步丰富 Nor Flash 产品系列，针对客户需求扩展产品型号，增强在高可靠性应用场景的解决方案能力；公司在 DRAM 现有产品基础上继续完善布局，拓展 DDR3、LPDDR4x 等产品线。公司持续提升存储产品的可靠性水平，稳步推进车规级存储产品的研发与产业化，积极构建高附加值的车规产品体系，Nand Flash 和 Nor Flash 车规系列产品已在多款车型中实现规模量产。</p> <p>在 Wi-Fi 板块，公司把握新一代 Wi-Fi 技术在高带宽、高安全、低延迟及多设备并发场景中的发展机遇，通过差异化技术创新，致力于提供本土化智能无线通信与感知芯片解决方案，持续推进 Wi-Fi7 无线通信芯片的研发，已完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。</p> <p>4、公司针对 MLC、TLC 产品以及 3D NAND 如何布局？</p> <p>答：公司目前的存储产品布局主要以中小容量、高可靠性存储产品为主。关于大容量产品的布局，公司基于现有的技术储备，将持续跟踪行业技术发展趋势、客户需求变化以及自身资金与技术实力进行评估。</p>
日期	2026年3月18日